

<<电子组装制造>>

图书基本信息

书名：<<电子组装制造>>

13位ISBN编号：9787030146083

10位ISBN编号：7030146085

出版时间：2005-2

出版时间：科学出版社

作者：(美国)C.A.哈珀编、贾松良等译

页数：416

字数：524000

译者：贾松良

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子组装制造>>

### 内容概要

电子组装制造是当前迅速发展的行业，本书集中介绍了电子组装制造的工艺与原材料。全书从有关电子组装制造的发展历程和半导体芯片的制备开始，依次介绍IC芯片封装、层压板制造、不同类型单层和多层线路板制造，以及各种线路板上元器件的安装技术、无铅焊料等焊接材料及其工艺，电路板的清洗涂覆，挠性和刚挠性电路板制造，各类陶瓷基板及复合材料，混合电路和模块的组装。

书中还专门介绍了电子组装制造中所涉及的环保问题和美国的相关法规。

书中不仅有大量的数据资料、实物图片、理论分析，还有许多宝贵的实践经验总结和设计规则。

本书可以作为从事电子组装制造、微电子封装及相关材料制造行业人员的参考资料，也可以用于相关专业研究生和高年级本科生的学习参考书。

## &lt;&lt;电子组装制造&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 印制电路的历史及概述 1.1 引言 1.2 电路技术 1.3 电路材料 1.4 电路板工艺 1.5 电路板结构和类型 1.6 用于电子封装的电路板 1.7 印制电路板的发展趋势 1.8 印制电路板的商业和经济效益 1.9 长期展望 参考文献第2章 集成电路芯片的发展和制造 2.1 引言 2.2 原子结构 2.3 真空管 2.4 半导体理论 2.5 集成电路基本原理 2.6 集成电路芯片制作 参考文献第3章 IC芯片封装 3.1 引言 3.2 IC封装 3.3 封装分类 3.4 封装技术 3.5 各种封装技术的比较 3.6 IC组装工艺 3.7 总结与展望 参考文献第4章 电路板基材——层压板和半固化片 4.1 引言 4.2 纸基材料 4.3 FR-4材料 4.4 复合材料 4.5 高性能材料 4.6 微孔材料 4.7 高速/高频材料 4.8 小结第5章 印制电路板制造 5.1 引言 5.2 背景和历史 5.3 结构材料 5.4 层压材料准备 5.5 层压方法 5.6 用于印制电路板的层压板形式 5.7 层压板的选择 5.8 阻焊膜 5.9 有镀通孔的印制电路板通用工艺综述 5.10 加成法和减成法工艺 5.11 单面电路工艺实例 5.12 双面电路板举例 5.13 标准的多层电路板工艺范例 5.14 批量层压 5.15 金属芯板印制电路板 5.16 挠性电路板 5.17 高密度互连结构 5.18 展望 5.19 小结 参考文献第6章 封装及元器件的粘接与互连第7章 电子组装制造中的焊接材料和工艺第8章 印制线路板清洗第9章 电路板的涂覆材料和工艺第10章 挠性和刚挠性电路板制造工艺第11章 电子陶瓷及复合材料的制备与性能第12章 混合微电子技术和多芯片模块技术第13章 电子组装制造中的环保考虑译后记

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>